

SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

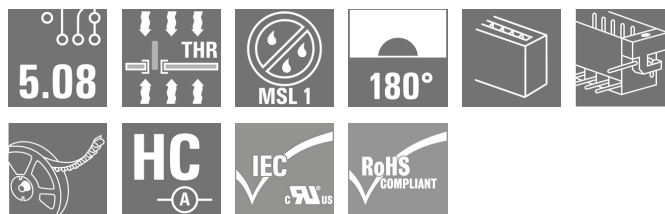
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Таре
Заказ №	1776464001
Тип	SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)	4032248163687
Кол.	205 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
Упаковка	Таре

Дата создания 2 октября 2024 г. 13:37:44 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	8,5 мм	Глубина (дюймов)	0,335 inch
Высота	13,5 мм	Высота (в дюймах)	0,531 inch
Высота, мин.	12 мм	Ширина	70,76 мм
Ширина (в дюймах)	2,786 inch	Масса нетто	8,522 g

Упаковка

Упаковка уровня ESD	токорассеивающий	Упаковка	Tape
Длина VPE	330 мм	VPE с	330 мм
Высота VPE	97 мм	Глубина ленты (T2)	17,45 мм
Ширина ленты (Ш)	88 мм	Глубина ленты с кармашками (K0)	16,95 мм
Высота ленты с кармашками (A0)	8 мм	Ширина ленты с кармашками (B0)	71,22 мм
Разделение кармашка ленты (P1)	16 мм	Перфорация для разделения ленты (E)	1,75 мм
Разделение кармашка ленты (F)	42,2 мм	Диаметр катушки с лентой ϕ (A)	330 mm
Поверхностное сопротивление	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$	Ширина контактной площадки Pick & Place (W_{PPP})	9,6 мм
Длина контактной площадки Pick & Place (L_{PPP})	12,36 мм	Диаметр извлекаемой поверхности (ϕ $D_{\text{макс.}}$)	8,5 мм
Выступ 1 контактной площадки Pick & Place ($L_{01 (PPP)}$)	2 мм	Выступ 2 контактной площадки Pick & Place ($P_{02 (PPP)}$)	2,3 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	5,08 мм
Шаг в дюймах (P)	0,2 "	Угол вывода	180°
Количество полюсов	12	Количество контактных штырьков на полюс	1
Длина штифта для припайки (l)	1,5 мм	Допуск на длину выводов под пайку	0 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку	d = 1,2 мм, восьмиугольный	L1 в мм	55,88 мм
L1 в дюймах	2,2 "	Количество рядов	1
Количество полюсных рядов	1	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106	защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470	IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения	Вид защиты	IP20
Объемное сопротивление	$\leq 5 \text{ m}\Omega$	Кодируемый	Да
Усилие вставки на полюс, макс.	9 N	Усилие вытягивания на полюс, макс.	7 N

SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	луженые	Структура слоев соединения под пайку	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C		


Номинальные характеристики по IEC

пройденны испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	19 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16,5 A	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2	400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2	320 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3	250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2	4 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2	4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3	4 kV		

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)	300 V
Номинальный ток (группа использования D/CSA)	18,5 A		

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)		Сертификат № (UR)	E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)	300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)	18,5 A	Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)	10 A
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	<ul style="list-style-type: none">• Позолоченные контактные поверхности по запросу• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.• Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм• Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов• Р на чертеже – шаг• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CB Certificate CB Testreport
Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	PCN 2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_neue_Tapeverpackung_Step_4_DE PCN 2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_new_Tape_Packaging_Step_4_EN Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL DRIVES EN FL DRIVES DE
Информационный документ: технология поверхностного монтажа	Download Whitepaper

Дата создания 2 октября 2024 г. 13:37:44 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



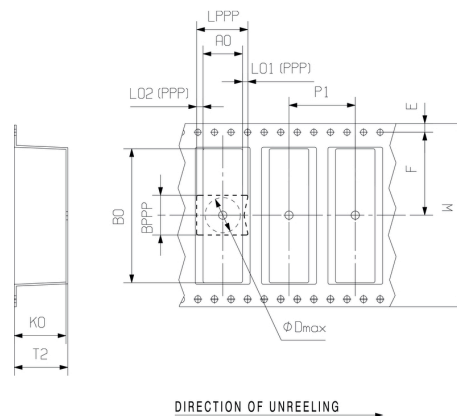
Dimensional drawing



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Пример использования



Преимущество изделия



Safe power transmission
Proven properties

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.